

2007年5月14日
NECエレクトロニクス株式会社

2007年 3月期 決算概要

<目 次>

2007年3月期 連結決算概要		頁 1
2007年3月期 決算短信		2
1. 経営成績		4
(1) 経営成績に関する分析		
(2) 財政状態に関する分析		
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当		
(4) 事業等のリスク		
2. 企業集団の状況		13
事業系統図		
3. 経営方針		15
(1) 会社の経営の基本方針		
(2) 目標とする経営指標		
(3) 中長期的な会社の経営戦略		
(4) 会社の対処すべき課題		
(5) 企業の社会的責任		
<連結財務諸表>		
比較連結損益計算書 〔年間〕		19
比較連結貸借対照表		20
比較連結資本勘定計算書		21
比較連結キャッシュ・フロー計算書		22
比較連結損益計算書 〔第4四半期〕		23
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項		24
セグメント情報		25
金融商品		
リース取引		
ストックオプション		
1株当たり当期純損益		
設備投資額・研究開発費		
<単独財務諸表>		
比較単独損益計算書		29
比較単独貸借対照表		30
株主資本等変動計算書		31
リース取引関係		32
有価証券関係		

問合せ先 NECエレクトロニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

<報道関係> 酒井／斎藤 TEL (044) 435-1676(直通)
<IR関係> 中西／矢筈／覚知 TEL (044) 435-1664(直通)

2007年3月期 連結決算概要

	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日) (至 2006年 3月31日)		2007年3月期 (自 2006年 4月 1日) (至 2007年 3月31日)		前 期 比 増(減)	
					金額	率
売上高	億円	%	億円	%	億円	%
半導体売上高	6,460	100.0	6,923	100.0	463	7.2
営業損益	6,191		6,597		406	6.6
税引前損益	△ 357	△5.5	△ 286	△4.1	71	—
当期純損益	△ 424	△6.6	△ 354	△5.1	70	—
	△ 982	△15.2	△ 415	△6.0	567	—
1株当たり当期純損益	円		円		円	%
基本的	△ 795.13		△ 336.04		459.09	—
希薄化後	△ 795.13		△ 336.04		459.09	—

設備投資額	億円	億円	億円	%
減価償却費	830	1,059	228	27.5
研究開発費	893	830	△ 64	△7.1
	1,209	1,318	109	9.0
米ドル為替レート (円)	円	円		
ユーロ為替レート (円)	112	117		
	138	149		

	2006年3月31日 現 在	2007年3月31日 現 在	前期末比 増(減)	
			金額	率
総資産	億円 7,453	億円 6,959	億円 △ 494	% △6.6
株主資本	3,083	2,651	△ 432	△14.0
従業員数	人 23,857	人 23,982	人 125	% 0.5

(注) ①億円未満を四捨五入して表示しております。

②当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

③1株当たり当期純損益は米財務会計基準書第128号「1株当たり利益」に基づいて算出しております。

④株主資本の金額は、米国会計基準に基づいて表示しております。

⑤本決算概要に記載された2007年3月期の連結財務情報につきましては、会計監査人による監査が終了していません。

今後、後発事象等の発生または会計監査人による監査により数値に変更が生じる場合があります。その場合、速やかに訂正のプレスリリースをいたします。



2007年3月期 決算短信〔米国会計基準〕

2007年5月14日

上場会社名 NECエレクトロニクス株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 6723 URL <http://www.necel.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中島 俊雄
 問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 遠藤 泰三 TEL (044) 435 - 1664
 定時株主総会開催予定日 2007年6月27日
 有価証券報告書提出予定日 2007年6月27日

(百万円未満四捨五入)

1. 2007年3月期の連結業績 (2006年4月1日～2007年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高	営業利益	税引前利益	当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
2007年3月期	692,280 7.2	△28,557 —	△35,375 —	△41,500 —
2006年3月期	645,963 △8.8	△35,689 —	△42,386 —	△98,198 —

	1株当たり 当期純利益	希薄化後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資産 税引前利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2007年3月期	△336.04	△336.04	△14.5	△4.9	△4.1
2006年3月期	△795.13	△795.13	△28.0	△5.4	△5.5

(参考) 持分法投資損益 2007年3月期 △468百万円 2006年3月期 ー百万円

(注) ① 1株当たり当期純利益は米国会計基準書第128号「1株当たり利益」に基づいて算出しております。

② 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業利益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
2007年3月期	695,886	265,068	38.1	2,146.32
2006年3月期	745,281	308,251	41.4	2,495.98

(注) 株主資本の金額は、米国会計基準に基づいて表示しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金および現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2007年3月期	66,731	△78,497	△15,273	185,372
2006年3月期	49,890	△54,673	△12,530	211,060

2. 配当の状況

	1株当たり配当金			配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	株主資本 配当率 (連結)
(基準日)	中間期末	期末	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2007年3月期	0.00	0.00	0.00	—	—	—
2006年3月期	0.00	0.00	0.00	—	—	—
2008年3月期 (予想)	0.00	0.00	0.00	—	—	—

3. 2008年3月期の連結業績予想 (2007年4月1日～2008年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高	営業利益	税引前利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %	円 銭
中間期	335,000 △2.3	△5,000 —	△12,000 —	△15,000 —	△121.46
通期	690,000 △0.3	0 —	△10,000 —	△15,000 —	△121.46

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動） 有

新規 1社（社名 NEC Electronics Korea Limited）

除外 2社（社名 NEC化合物デバイス(株)、NECデバイスポート(株)）

（注）詳細は、13ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

- (2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

- (3) 発行済株式数（普通株式）

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 2007年3月期 123,500,000株 2006年3月期 123,500,000株

②期末自己株式数 2007年3月期 1,445株 2006年3月期 1,020株

③期中平均株式数 2007年3月期 123,498,823株 2006年3月期 123,499,052株

（参考）個別業績の概要

1. 2007年3月期の個別業績（2006年4月1日～2007年3月31日）

(1) 個別経営成績

（％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2007年3月期	596,141	17.6	△49,234	—	△55,192	—	△77,521	—
2006年3月期	506,747	△10.0	△64,317	—	△66,942	—	△95,964	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2007年3月期	△627.71	—
2006年3月期	△777.04	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2007年3月期	553,904	266,162	48.0	2,154.97
2006年3月期	632,648	349,423	55.2	2,829.36

（参考）自己資本 2007年3月期 266,144百万円 2006年3月期 349,423百万円

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、業績見通しと乖離する可能性があります。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経済および事業環境

当期の世界経済は、年度前半は堅調に推移しましたが、後半からは後退を示唆する兆候が現れ、減速基調となりました。地域別にみると、米国においては、政策金利が高止まりしたことなどから住宅投資が減速し、アジアにおいては、IT関連機器や液晶パネル等の在庫調整が occurred。安定的に内需が拡大した欧州や日本においても、年度後半からは外需の伸び悩みの影響が現れ、景気が減速しました。

半導体市場も、世界経済と同様に、昨年夏以降は需要の伸びが減速し、特にDRAMを除いた半導体出荷全体の伸び率は、年度後半には月次で前年比マイナス成長を記録しました。新興国での携帯電話の普及などで、アジアを中心に数量ベースでの伸びは続きましたが、単価の下落などにより金額ベースでは伸び悩み、わが国の半導体市場においても、携帯電話の普及率飽和に伴う成長鈍化やデジタル家電製品の価格下落等の影響により、特に年明け前後より市場の伸びが減速いたしました。

② 当期の連結業績

(単位 億円)

	前期	当期	増(減)	
売上高	6,460	6,923	463	7.2%
営業損益	△357	△286	71	-
税引前損益	△424	△354	70	-
当期純損益	△982	△415	567	-
米ドル為替レート(円)	112	117	-	-
ユーロ為替レート(円)	138	149	-	-

当期の連結売上高は6,923億円と、前期と比べ463億円(7.2%)の増加となりました。これは、主に携帯電話端末向けメモリやパソコン周辺機器向け半導体の売上減により、通信機器分野やコンピュータおよび周辺機器分野の売上が減少したものの、新規のゲーム機向け半導体の出荷開始やデジタルテレビ向け半導体の売上増により、民生機器分野の売上が大きく増加したことに加えて、「オール・フラッシュ・マイコン」の拡販等により多目的・多用途分野の売上も大きく増加したことによるものです。

連結営業損益は286億円の損失で、前期と比べ71億円の改善にとどまりました。これは、連結売上高は前期と比べ増加したものの、研究開発費や生産能力増強のための投資が増加したことに加えて、製品価格の下落に製造原価低減が追いつかなかったことによるものです。さらに、開発プロジェクトの集約関係費用など、将来の体質改善に向けた一時費用を当期に計上したこともその要因となっております。

連結税引前損益は354億円の損失で、営業損益と同様、前期と比べ70億円の改善にとどまりました。

連結当期純損益は415億円の損失で、法人税等の減少により前期と比べ567億円の改善となりました。これは、主に前期の法人税等に繰延税金資産の取崩しが含まれていたことによるものです。

③ 製品分野別連結売上高実績

製品分野別の外部顧客に対する連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

	前期	当期	増(減)	
通 信 機 器 分 野	1, 0 8 0	9 9 6	△ 8 4	△7.7%
コンピュータおよび周辺機器分野	1, 2 6 6	1, 2 3 7	△ 2 9	△2.3%
民生用電子機器分野	1, 0 2 6	1, 2 0 8	1 8 1	17.7%
自動車および産業機器分野	1, 0 3 8	1, 0 6 1	2 3	2.2%
多 目 的 ・ 多 用 途 I C	6 9 4	8 9 0	1 9 5	28.1%
ディスクリート・光・マイクロ波	1, 0 8 7	1, 2 0 6	1 1 9	10.9%
半 導 体 計	6, 1 9 1	6, 5 9 7	4 0 6	6.6%
そ の 他	2 6 8	3 2 5	5 7	21.4%
合 計	6, 4 6 0	6, 9 2 3	4 6 3	7.2%

◆ 通信機器分野 売上高 996億円(前期比7.7%減)

通信機器分野の売上高は、前期と比べ84億円(7.7%)減少し、996億円となりました。

当分野には、ルータ、携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や携帯電話端末向け半導体が含まれます。

当期は、携帯電話端末向け半導体の売上が前期と比べ減少しました。これは、高精細TFT-LCD(薄膜トランジスタ方式液晶ディスプレイ)を搭載した携帯電話端末の普及が進んだことなどにより、LCD(液晶ディスプレイ)ドライバICの売上は増加したものの、携帯電話端末向けメモリの売上が大幅に減少したことなどによるものです。

◆ コンピュータおよび周辺機器分野 売上高 1,237億円(前期比2.3%減)

コンピュータおよび周辺機器分野の売上高は、前期と比べ29億円(2.3%)減少し、1,237億円となりました。

当分野には、サーバおよびワークステーション向け半導体やパソコンおよびパソコン周辺機器向け半導体が含まれます。

当期は、パソコン周辺機器向け半導体の売上が前期と比べ減少しました。これは、液晶テレビやパソコン用モニタ向けLCDドライバICは市場シェア拡大により売上が増加したものの、プリンタ向け半導体や、記録型DVD(デジタル多用途ディスク)ドライブ向け半導体の売上が減少したことなどによるものです。

◆ 民生用電子機器分野 売上高 1,208億円(前期比17.7%増)

民生用電子機器分野の売上高は、前期と比べ181億円(17.7%)増加し、1,208億円となりました。

当分野には、家電製品向け半導体やゲーム機向け半導体が含まれます。

当期は、ゲーム機向け半導体の売上が前期と比べ大きく増加しました。これは、新規のゲーム機向け製品の出荷が開始されたことによるものです。加えて、ゲーム機向け以外にも、デジタル家電製品の幅広い普及により、デジタルカメラやデジタルテレビ向け半導体の売上も増加しました。

◆ 自動車および産業機器分野 売上高 1, 061 億円 (前期比 2. 2%増)

自動車および産業機器分野の売上高は、前期と比べ 23 億円 (2. 2%) 増加し、1, 061 億円となりました。

当分野には、自動車向け半導体、F A (ファクトリー・オートメーション) 機器などの産業機器向け半導体が含まれます。

当期は、自動車の電子化の進展により自動車に搭載される半導体の数量が増加したことなどに伴い、自動車向け半導体の売上が前期と比べ増加しました。

◆ 多目的・多用途 I C 売上高 890 億円 (前期比 28. 1%増)

多目的・多用途 I C の売上高は、前期と比べ 195 億円 (28. 1%) 増加し、890 億円となりました。

当分野には汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途の S R A M などが含まれます。

当期は、汎用マイクロコントローラの売上が前期と比べ大幅に増加しました。これは、汎用マイクロコントローラ市場の回復に加え、「オール・フラッシュ・マイコン」の売上が増加したことなどによるものです。

◆ ディスクリート・光・マイクロ波 売上高 1, 206 億円 (前期比 10. 9%増)

ディスクリート・光・マイクロ波の売上高は、前期と比べ 119 億円 (10. 9%) 増加し、1, 206 億円となりました。

当分野には、ダイオード、トランジスタなどのディスクリート半導体、光通信や D V D 向け光半導体、携帯電話端末などに使用されるマイクロ波半導体が含まれます。

当期は、ディスクリート半導体の売上が市場の回復等に伴い前期と比べ増加しました。

◆ そ の 他 売上高 325 億円 (前期比 21. 4%増)

その他の売上高は、前期と比べ 57 億円 (21. 4%) 増加し、325 億円となりました。

当分野には、主に当社の販売子会社が行っている L C D パネルの再販など、半導体以外の製品の販売事業が含まれます。

同事業は、当社グループの主力事業ではなく、当社グループ全体の業績に対する影響は殆どありません。

④ 所在地別連結売上高実績

当社あるいは当社の子会社の所在地別に分類した外部顧客への連結売上高は次のとおりです。

		(単位 億円)			
		前期	当期	増(減)	
日	本	3,529	3,773	244	6.9%
米	国	769	675	△94	△12.2%
欧	州	730	889	159	21.9%
ア	ジ	1,433	1,586	153	10.7%
ア	ア				
合 計		6,460	6,923	463	7.2%

◆ 日 本 売上高 3,773億円(前期比6.9%増)

日本では、プリンタ向け半導体やPDP(プラズマディスプレイ)向けドライバICなどの売上が減少したものの、ゲーム機向け半導体の売上が大幅に増加したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ244億円(6.9%)増加し、3,773億円となりました。

◆ 米 国 売上高 675億円(前期比12.2%減)

米国では、携帯電話端末向けメモリの売上が減少したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ94億円(12.2%)減少し、675億円となりました。

◆ 欧 州 売上高 889億円(前期比21.9%増)

欧州では、STB(セット・トップ・ボックス)向け画像処理LSIや、自動車向け半導体、汎用マイクロコントローラの売上が増加したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ159億円(21.9%)増加し、889億円となりました。

◆ アジア 売上高 1,586億円(前期比10.7%増)

アジアでは、液晶テレビやパソコン用モニタ向けLCDドライバICや、汎用マイクロコントローラ、ディスクリット半導体の売上が増加したことなどにより、当期の売上高は、前期と比べ153億円(10.7%)増加し、1,586億円となりました。

⑤ 来期の見通し

半導体市場においては、昨年後半からの減速基調が継続しており、在庫調整は一服したものの、本格的な回復は来期半ば前後からと見込まれております。来期後半についても予断を許さない状況ではありますが、2008年の北京オリンピックをにらみ需要の回復が想定されております。

当社グループにおいては、2007年2月に策定した新たな経営方針に基づき、まずは一刻も早い黒字回復を目指し、全社を挙げて取り組んでおります。来期の見通しに関しては、連結売上高は、当期に比べほぼ横這いの6,900億円を見込んでおりますが、うち、半導体売上高については6,700億円と約1.6%の増収を見込んでおります。足もとの受注環境において、大型LCDドライバICなど一部の製品に需要の回復がみられるものの、来年度上期の業績については依然として厳しい状況が続くと見込んでおりますが、オリンピックをにらんだ半導体市場の回復により、来年度中盤からは特にデジタル家電製品向け半導体を中心に売上の回復を見込んでおります。連結営業利益については、半導体売上の増加による収益改善に加え、固定費の削減を中心とした経営の効率化等により0億円を見込んでおります。また、連結税引前利益は100億円の損失、連結当期純利益は150億円の損失を見込んでおります。

(2008年3月期の連結業績予想)

		(当期比)
売上高	6,900億円	△0.3%
(半導体売上高)	6,700億円	1.6%
営業利益	0億円	—
税引前利益	△100億円	—
当期純利益	△150億円	—

なお、来期の通期業績見通しにあたっては、1米ドル115円、1ユーロ150円を前提としております。

当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

(2) 財政状態に関する分析

① 総資産および株主資本

(連結財政状態)		(単位 億円)	
	2006年3月末	2007年3月末	増(減)
総 資 産	7,453	6,959	△494
株 主 資 本	3,083	2,651	△432
株 主 資 本 比 率(%)	41.4	38.1	△3.3
1株当たり株主資本(円)	2,496	2,146	△350
有 利 子 負 債	1,483	1,360	△123

当期末の総資産残高は、6,959億円で、前期末と比べ494億円の減少となりました。これは、主に前期において取得した生産設備等の支払などにより、現金および現金同等物が257億円減少したことなどによるものです。

株主資本は、2,651億円で、前期末と比べ432億円の減少となりました。これは、連結当期純損失を415億円計上したことなどによるものです。

株主資本比率は、株主資本の減少により前期末と比べ3.3ポイント低下しました。

有利子負債は、借入金の返済などにより、前期末と比べ123億円減少し、1,360億円となりました。

② キャッシュ・フロー

(連結キャッシュ・フローの状況)		(単位 億円)		
		前期	当期	増(減)
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4 9 9	6 6 7	1 6 8
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5 4 7	△ 7 8 5	△ 2 3 8
	フリー・キャッシュ・フロー	△ 4 8	△ 1 1 8	△ 7 0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1 2 5	△ 1 5 3	△ 2 7
	為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	2 7	1 6	△ 1 1
	現金および現金同等物純増加(減少)額	△ 1 4 6	△ 2 5 4	△ 1 0 8
	現金および現金同等物期首残高	2, 2 5 7	2, 1 1 1	△ 1 4 6
	現金および現金同等物期末残高	2, 1 1 1	1, 8 5 4	△ 2 5 7

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛金の減少や買掛金の増加による運転資金の改善などにより667億円の収入で、前期と比べ168億円の収入増となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、所有設備の売却による収入が減少したことや、有形固定資産の購入による支払が増加したことなどから785億円の支出で、前期と比べ238億円の支出増となりました。

以上の結果、フリー・キャッシュ・フローは118億円の支出で、前期と比べ70億円の支出増となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により153億円の支出で、前期と比べ27億円の支出増となりました。

以上により、現金および現金同等物純増加(減少)額は254億円の減少となり、海外子会社の決算期変更による減少もあわせると、現金および現金同等物期末残高は1,854億円となり、前期末と比べ257億円の減少となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、企業価値の最大化の観点から、新製品の研究開発、設備投資などのために内部留保を重視し、強靱な財務体質の実現を目指しながら、利益の一部を配当してまいります。各期の配当の金額につきましては、連結および単独の利益剰余金の状況、連結の利益の状況、翌期以降の利益見通しおよびキャッシュ・フローの状況などを考慮し決定いたします。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当期(2007年3月期)の配当につきましては、連結・単独業績とも当期純損失を計上するに至ったこと、また連結・単独とも累積損失の状況にあることから、これを見送らせていただきます。

次期(2008年3月期)の配当につきましては、連結業績が当期純損失を計上する見込みであることから中間・期末ともこれを見送らせていただく予定ではありますが、できるだけ早期に配当を再開すべく、業績の改善および財政状況の改善に努めてまいります。

(4) 事業等のリスク

当社グループが認識している事業等のリスクのうち、主要なものは以下のとおりであります。

① 市況変動(シリコンサイクル)による影響

半導体市場は、シリコンサイクルと呼ばれる循環的な市況変動で知られております。当社グループは、常に市況の動向を見極めながら事業活動を遂行しておりますが、世界各国の景気循環や最終製品の需要の変化などに起因する市況変動の影響を完全に回避することは困難であるため、市況が下降した局面においては、売上の減少や、工場稼働率の低下による原価率の悪化により、大幅に収益が悪化する可能性があります。

② 為替の変動による影響

当社グループの経営成績および財政状態は、為替相場の変動によって影響を受けます。当社グループは、こうした為替相場の変動による影響を回避または軽減するため、先物為替予約をはじめとして様々な対策を講じておりますが、為替相場が大きく変動した場合、外貨建製品の売上高、外貨建の資材コスト、海外工場の生産コスト等が影響を受ける可能性があります。また、当社の外貨建の資産・負債を日本円に換算表示すること、さらに、海外子会社における外貨表示の財務諸表を日本円に換算表示することによっても、当社グループの資産・負債および収益・費用は変動します。

③ 自然災害等のリスク

地震、台風、洪水等の自然災害、事故、テロをはじめとした当社グループがコントロールできない事由によって、所有する半導体工場等の設備が深刻な損害を被り、その操業を停止せざるを得なくなる可能性があります。特に、当社グループは、地震が発生する確率が世界の平均より高いと考えられる地域に重要な設備を保有しており、地震の発生時には、その影響により工場等の操業を停止せざるを得ない可能性があります。当社グループでは、地震による損害発生に備えて地震保険に加入しておりますが、それにより損害を全額補填できるという保証はありません。

④ 競争による影響

半導体事業は熾烈な競争状態にあり、当社グループは、製品の性能、構成、価格、品質等の様々な点で、国内外の多くの同業他社との激しい競争にさらされております。当社グループでは、競争力の維持強化に向けて、先端技術の開発、設計のプラットフォーム化、原価低減の推進等の様々な施策に取り組んでおりますが、競争力を維持することができなかった場合、製品のマーケットシェアが低下し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、熾烈な市場競争により、製品の販売価格が急激に低下し、原価低減では補い切れずに、粗利益率の悪化に見舞われる可能性があります。

⑤ 設備、研究開発に対する誤った投資判断のリスク

当社グループは、I D M (Integrated Device Manufacturer : 垂直統合型デバイスメーカー) として、販売する半導体製品の多くをグループ内で開発・生産しており、技術革新や増産に対応するため、毎年多額の設備投資を行っております。当社グループでは、常に適切な設備投資を行うことを目指しておりますが、投資のタイミングや規模等の判断を誤った場合、機会損失や稼働損が発生する可能性があります。

また、当社グループは、先端技術の研究開発に多額の投資を行っておりますが、開発テーマの選定の誤りや開発の遅れ等により、売上や収益への貢献が得られず、投じた研究開発投資が無駄になる可能性があります。

⑥ 製品の欠陥、異常または故障に関するリスク

当社グループでは、様々な施策を通じて、ソフトウェアを含む製品の品質向上に取り組んでおりますが、これらの製品に用いられる技術の高度化、顧客における製品の使用方法の多様化等により、出荷時に発見できない欠陥、異常または故障が製品に存在する場合があります。顧客の最終製品に組み込まれた後に当該欠陥、異常または故障が発見される可能性があります。この場合、製品の返品や交換、損失の補償、製品の採用打ち切りなどの結果につながり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした事態に備えて、当社グループでは、生産物賠償責任保険、生産物回収費用保険等の保険に加入しておりますが、それにより損失を全額補填できるという保証はありません。

⑦ 長期性資産の減損のリスク

当社グループは、有形固定資産など多くの長期性資産を保有していますが、長期性資産の連結貸借対照表計上額について、当該資産から得られる将来のキャッシュ・フローによって、資産の残存価額を回収することができるかどうかを定期的に検討しています。当該資産が十分なキャッシュ・フローを生み出さない場合は、当社および当社グループは長期性資産につき減損を認識しなければならない可能性があります。

⑧ 法的事項等

当社グループ製品は、広範囲にわたる技術を使用しておりますが、こうした技術が第三者の保有する知的財産権を侵害しているとの主張が当社グループに対してなされる可能性があります。このような主張を受けた場合、当社グループおよび顧客を防御するため、訴訟対応費用を含む多額の費用が発生する可能性があります。それに加えて、最終的には巨額の損害賠償を命じられたり、経済合理性を超えた技術使用料の請求により、その技術を利用できなくなったりする可能性があります。

また、当社グループの事業は、環境、安全、公正取引等に関する日本国および諸外国の様々な法令や政府の規制の適用を受けております。当社グループは、こうした法令・規制を遵守すべく対応しておりますが、万一法令・規制の違反を理由とする訴訟や法的手続において、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当社の米国子会社である NEC Electronics America, Inc. は、米国 DRAM 業界における独占禁止法（反トラスト法）違反行為による損害賠償を求める直接購入者（過去において当社グループから直接 DRAM を購入した顧客）からの複数の民事訴訟（集団訴訟）の被告になっております。これらの集団訴訟は和解により終了する見込みであります。また、NEC Electronics America, Inc. は、独占禁止法違反行為による損害賠償を求める、間接購入者（DRAM が含まれた製品の購入者）からの複数の集団訴訟および米国の複数の州の司法長官による訴訟の被告にもなっております。

当社グループは、欧州においても DRAM 業界における競争法違反行為の可能性について欧州委員会が行う調査に協力して、日本電気(株)とともに情報提供を行っております。

さらに、当社グループは、これらに加え (i) SRAM 業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省および欧州委員会の調査、(ii) 半導体業界における韓国独占禁止法違反の可能性に関する韓国公正取引委員会の調査、ならびに (iii) TFT 液晶ディスプレイ業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省、欧州委員会、韓国公正取引委員会およびカナダ競争当局の調査の対象となっています。また、SRAM 業界および TFT 液晶ディスプレイ業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省の調査開始後、NEC Electronics America, Inc. に対し、独占禁止法違反行為による損害賠償を求める複数の民事訴訟が米国等で提起されております。

これらの独占禁止法違反を理由とする民事訴訟、和解交渉および当局による種々の調査については、現時点では結論は出ておりませんが、米国での DRAM に係る民事訴訟および和解交渉に関し今後発生する可能性のある諸費用の見積額を引き当てております。

2. 企業集団の状況

当社企業グループの連結子会社（25社）を事業分野別に記載すると次のとおりとなります。

生 産 会 社	販 売 会 社
山形日本電気(株)	NEC Electronics (Europe) GmbH
福井日本電気(株)	NEC Electronics Taiwan Ltd.
関西日本電気(株)	NEC Electronics Singapore Pte. Ltd.
山口日本電気(株)	日電電子（中国）有限公司（注③）
九州日本電気(株)	NEC Electronics Hong Kong Limited
N E Cセミコンパッケージ・ソリューションズ(株)	上海恩益禧電子国際貿易有限公司
N E Cファブサブ(株)	NEC Electronics (UK) Limited（注④）
NEC Electronics America, Inc.（注①）	NEC Electronics Korea Limited（注⑤）
NEC Semiconductors Ireland Limited（注②）	NEC Compound Semiconductor Devices Hong Kong Limited（注⑥）
NEC Semiconductors Singapore Pte. Ltd.	
NEC Semiconductors (Malaysia) Sdn. Bhd.	
P.T. NEC Semiconductors Indonesia	
首鋼日電電子有限公司	

設 計 会 社	そ の 他
N E Cマイクロシステム(株)	日本電子ライト(株) (株)近畿分析センター

（注①）NEC Electronics America, Inc. は生産および販売を担当しております。

（注②）NEC Semiconductors Ireland Limitedは、2006年9月をもって生産および出荷活動を終了しました。

（注③）日電電子（中国）有限公司は、販売および設計を担当しております。

（注④）NEC Electronics (UK) Limitedは、休眠会社です。

（注⑤）NEC Electronics Korea Limitedは、2006年9月1日付で当社の100%子会社として設立され、2006年11月1日から営業活動を開始しています。

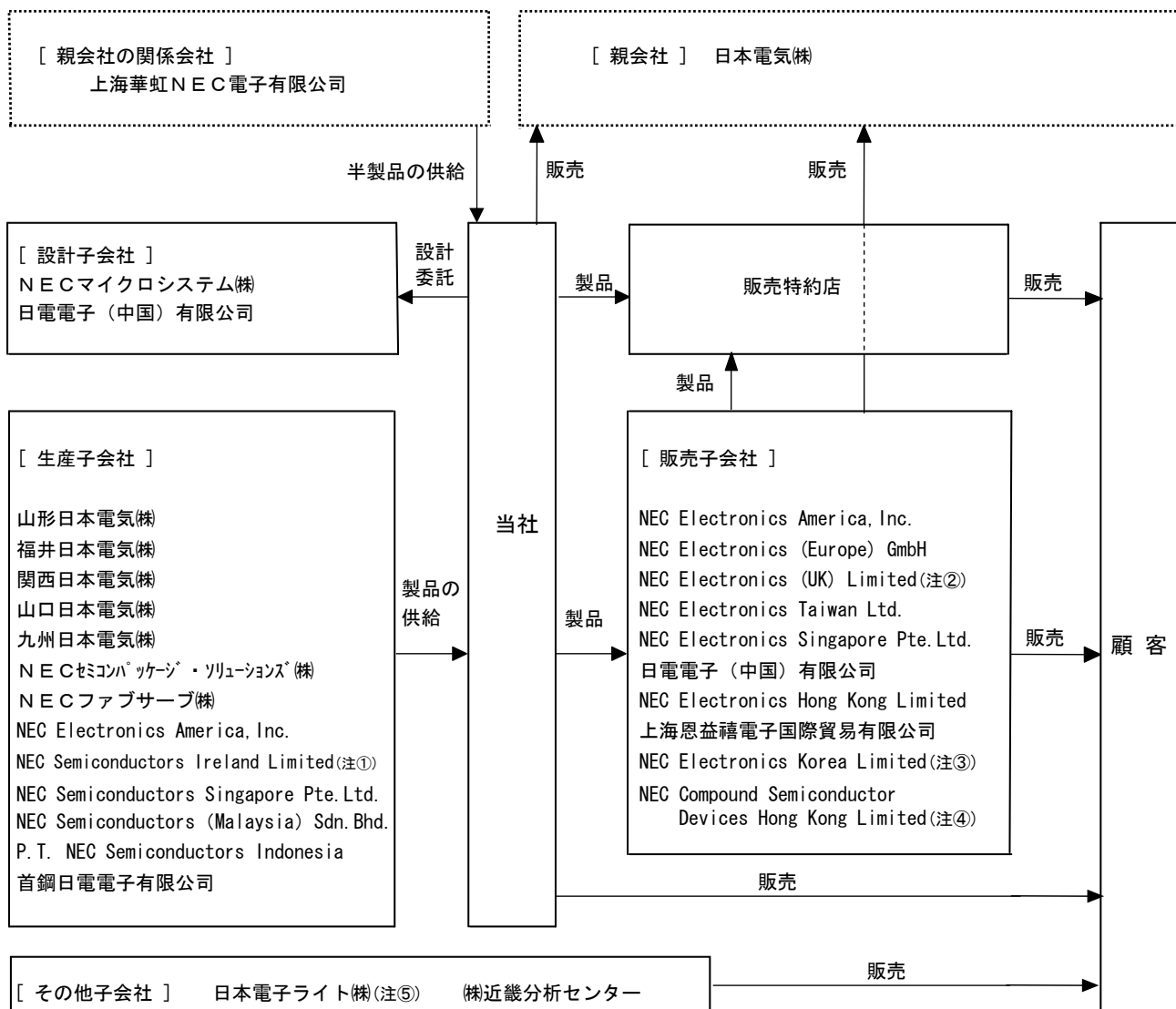
（注⑥）NEC Compound Semiconductor Devices Hong Kong Limitedは、2006年11月1日付でNEC Electronics Hong Kong Limitedに事業統合され、販売活動を終了しました。

（注⑦）N E C化合物デバイス(株)は、2006年4月1日付で当社に吸収合併（簡易合併）されました。

（注⑧）N E Cデバイスポート(株)は、2006年11月1日付で当社に吸収合併（簡易合併）されました。

【事業系統図】

当社グループにおける主要な関係会社の事業の系統は、概ね図のとおりです。



(注①) NEC Semiconductors Ireland Limitedは、2006年9月をもって生産および出荷活動を終了しました。

(注②) NEC Electronics (UK) Limitedは、休眠会社です。

(注③) NEC Electronics Korea Limitedは、2006年9月1日付で当社の100%子会社として設立され、2006年11月1日から営業活動を開始しています。

(注④) NEC Compound Semiconductor Devices Hong Kong Limitedは、2006年11月1日付で NEC Electronics Hong Kong Limitedに事業統合され、販売活動を終了しました。

(注⑤) 日本電子ライト(株)は、関西日本電気(株)を経由して販売している製品も含まれています。

(注⑥) NEC化合物デバイス(株)は、2006年4月1日付で当社に吸収合併(簡易合併)されました。

(注⑦) NECデバイスポート(株)は、2006年11月1日付で当社に吸収合併(簡易合併)されました。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「最先端独自技術を背景に、お客様のニーズに応え、最適なソリューションを提供するビジネスパートナーになること」を目指す半導体メーカーです。

当社グループは、以下の方針に基づき、企業価値・株主価値の増大を目指してまいります。

- すべての事業活動において顧客志向を徹底し、ソリューション提案力や品質の向上を図り、顧客満足度の向上を通じて、売上と収益を拡大します。
- S o C（システム・オン・チップ）、マイクロコンピュータ、個別半導体という3つの製品群を事業の柱とし、それぞれの製品群の特性に適した事業運営を行うとともに、各製品群の間で共通する技術と設備を活用することにより、顧客の多様なニーズを高品質かつ低コストで実現し、成長と収益性向上を実現します。
- 全世界の顧客へのアクセスを強め、グローバルプレイヤーとして、世界中のビジネスチャンスを積極的に掴み、売上を拡大します。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、総資産利益率・株主資本利益率の向上のためには、売上高に対する利益率を改善することが最重要と考え、連結の売上高営業利益率の向上を目標としております。しかしながら、当期の業績は二期連続の赤字決算となったことから、まずは一刻も早い黒字回復を目指します。また、2007年2月に策定した新たな経営方針を着実に実行することにより、半導体の市況悪化時にも収益を生み出すことのできる強靱な事業体質を構築すべく、全社を挙げて取り組んでまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

上記の基本方針の実現のため、中期的な経営戦略として、以下の施策を実行してまいります。

① プラットフォーム化によるソリューション構築力の向上

S o C事業やマイクロコンピュータ事業には、半導体のプロセス技術、回路技術、開発環境（設計を支援するツールやマニュアル）、OS（オペレーティング・システム）やドライバをはじめとしたソフトウェアの整備などからなる一連のシステムが必要です。当社グループでは、その一連のシステムを「プラットフォーム」と称し、プラットフォームの整備拡充と共通化により、製品開発の効率化を進めるとともに、顧客に提供するソリューションの使い勝手や完成度の向上に努めています。

プラットフォーム構築の具体例としては、業界内でも定評のある「オール・フラッシュ・マイコン」やデジタル映像分野の「EMMA™」シリーズなどが挙げられます。これらの競争力のあるプラットフォームに対しては、外部のソフトウェア開発会社などから、ソフトウェアや設計ツール等の関連機器を積極的に提供いただけるため、顧客へのソリューション構築力を向上させることが可能となります。

今後もソリューション構築力の強化に向け、競争力のあるプラットフォーム構築を推進してまいります。

② 品質の一層の向上

顧客満足度の向上にとって非常に大切な要素は、当社グループの提供するソリューションの品質です。ソリューション全体の品質向上のため、ソリューションを構成する半導体とソフトウェアのそれぞれにつき、当社グループ全体の品質基準を統一化・明確化し、その厳格な適用を徹底してまいります。

また、半導体の品質の向上には、設計から製造までの一連の工程ごとに高いレベルでの品質を確保する「品質の作り込み」が重要であることから、各工程において異常発生を未然に防止するための仕組みを整備するとともに、万一、異常が発生した場合には、不良品の次工程への流出を防ぐチェック体制を整え、ゼロ・ディフェクト（不良ゼロ）を目指してまいります。ソフトウェアの品質の向上のためには、ソフトウェアの設計手法の標準化と設計にかかわるプロジェクトマネジメントの徹底を行います。

③ 戦略的提携の積極的活用

当社グループでは、同業他社や半導体商社といったパートナーとの戦略的な提携を積極的に活用し、当社グループに不足している経営資源を補うことにより、売上と収益の拡大を目指してまいります。

S o C事業のプラットフォーム開発には膨大な人員、資金および時間が必要となります。当社は半導体の微細加工にかかわる先端プロセス技術に関して株式会社東芝との間で共同開発を行っておりますが、これは、プラットフォームの一要素であるプロセス技術の開発費負担を軽減し、開発期間を短縮するためにパートナーとの協業が最適と判断したことによるものです。

また、当社グループでは、従前から国内外の半導体商社と販売特約店契約を締結して密接なパートナーシップを構築し、全世界の幅広い顧客に販売とサポートを行う強固な販売体制を構築しています。特に、汎用マイクロコントローラやディスクリート半導体のように、製品数と顧客数が多岐にわたる製品では、半導体商社とのパートナーシップが製品の拡販のためには必須であり、今後ともこれらの商社との関係強化に努めてまいります。

（４）会社の対処すべき課題

経営の基本方針および中期的な経営戦略を実行するため、現在、当社グループでは下記の事項につき、対処すべき課題として取り組んでおります。

① 開発リソースの集中による開発費効率の改善と売上の拡大

当社グループは、これまで、売上拡大を通じた収益の改善を目指して、積極的に研究開発費を増額してまいりました。しかし、開発する品目が多岐にわたり、開発費や開発人員といった開発リソースが分散した結果、特定の製品に開発リソースを集中する専門メーカーとの競争において不利となり、収益の低迷を招く結果となりました。

この反省にもとづき、今後は、製品開発におけるフォーカス（集中化）をより強化し、競争劣位に陥った製品の開発中止と、戦略製品にかける開発費の増額の組み合わせにより、開発費総額を抑制しつつ、売上成長の確度を高める方針へと転換します。

この方針の変更により、売上高比の研究開発費比率の引き下げを実現するとともに、開発の重点化による強い製品の創出を通じて、中期的な売上の拡大と、粗利益率の向上を実現すべく努力してまいります。

② 生産ラインの統廃合による製造原価低減の加速

開発リソースの分散により、当社グループの製品競争力が相対的に落ちた結果、市場での価格引下げ圧力が強まり、売上原価率が中期的に悪化する傾向が続いています。このような状況を打破するために、開発リソースの集中化による製品ラインの強化を行うとともに、コスト競争力を重視した生産体制への見直しを行い、上昇した売上原価率を引き下げるために、当社グループ全体の生産ラインの統廃合等の構造改革の推進により製造原価低減に取り組んでまいります。

具体的には、ウエハ加工を行う前工程の小規模なラインや旧式なラインについては、既存製品の事業継続に配慮しつつも、可能な限り早急に縮小または閉鎖し、生産数量がより大きなラインや、より大口径のラインへの集約を図り、個々のラインでの生産量を拡大します。また、組立と検査を中心とした後工程については、人件費率の高い製品や生産数量の多い製品を中心に、国内の生産工場から人件費の安いアジアの生産工場へと生産を移管し、マレーシア・中国等、海外の当社グループ会社での増産により、コスト競争力を強化します。これらの施策の実行には、生産技術の移転、生産移管の前後における品質レベルの維持や、移管についての製品毎の顧客からの同意取得など、様々な課題がありますが、中期的な製造原価低減には必須の施策として、これらの早期の実行に全力を挙げてまいります。

③ 製品群毎に最適化された、営業・開発・生産の流れの再構築

当社グループの製品群は、S o C、マイクロコンピュータ、個別半導体と、大きく3つに分類できますが、従来から当社では、これら事業の推進において、営業・開発・生産という機能別分業体制を採用してきました。この機能別の分業体制は、機能毎の効率化・最適化には適しているものの、営業から生産までの流れを3つの製品群毎に最適化することは難しく、3つの事業の特徴にあった個別の売上拡大施策の実行と製造原価低減の推進には、必ずしも最適とはいえない点がありました。

そこで、当社は、2007年5月7日に組織改正を行い、S o C、マイクロコンピュータ、個別半導体という3つの事業を、各事業の特徴を踏まえたうえで、そこでの当社グループの強みを生かして、各々の事業を拡大していくために最適な組織体制へと変更しました。その組織改正の骨子は下記のとおりです。

- (i) 当社グループの事業を、S o C、マイクロコンピュータ、個別半導体の3つの製品軸による事業に再編し、それぞれに対応する当社の組織をビジネスユニットと称する。
- (ii) 各ビジネスユニットには、生産対応機能の一部を移管し、事業遂行の責任と権限を強化する。
- (iii) 営業部門においては、顧客別営業体制を維持しつつ、各ビジネスユニットに対応した販売促進部門を増員し、製品マーケティング機能を強化する。
- (iv) 全社的に細分化されていた小規模な部門を統廃合することにより、人材の流動性を高め、業務運営を効率化する。

この組織改正により、当社グループ全体の営業から開発、生産までの流れを製品群毎に一貫したものとし、市場の変化に即応できる体制を構築することで、各製品群の売上拡大と製造原価低減を実現し、収益の拡大を図ってまいります。

(5) 企業の社会的責任

当社グループは、2004年6月に、経営指針となる「NECエレクトロニクスグループ企業行動憲章」を制定するとともに、CSR推進委員会を設置するなど、全社的なCSR (Corporate Social Responsibility: 企業の社会的責任) 推進体制を整えました。2005年4月には、個人情報保護法の全面施行を受け、規程の見直しや社内への周知徹底など、個人情報保護の推進体制を整備しました。また、当社グループでは、持続可能な社会の実現に向けて組織が発行する報告書の世界的な基準「GRIサステナビリティガイドライン」に沿って、CSRレポート、アニュアル・レポート、環境経営報告書の3冊の報告書による情報開示を行っております。

地域に密着した社会貢献活動としては、従来から行っている水源林保護活動や地域の清掃活動に加えて、2006年10月から地元の小学生たちに電子・電気に関心を深めてもらうことを目的として、半導体を活用した電子工作教室を開催するなど、地域社会との積極的な交流を図っております。

当社グループは、以下の内容に基づき、良き企業市民として社会的責任を果たすことが継続的な企業価値・株主価値の増大につながると考えております。

NECエレクトロニクスグループ企業行動憲章

私たちNECエレクトロニクスグループは、健全な事業活動をとおして、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、従業員をはじめとするすべての関係者から信頼される存在となることを目指しています。

そのため、良き企業市民として法令を守って誠実に行動し、以下の指針に基づいて社会的責任を果たしていくとともに、高い技術力を基盤とした魅力ある半導体ソリューションの提供に取り組んでまいります。

- お客様志向
最適かつ高品質のソリューション提供をとおして、お客様の満足向上を追求し、お客様からの揺るぎない信頼を獲得します。
- 誠実で透明な企業活動
公平、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進するとともに、その活動内容の積極的な公開に努めます。
- 地域社会、国際社会への貢献
グローバルカンパニーとして、国や地域の歴史、文化、慣習、人権を尊重し、地域社会、国際社会に貢献します。
- 地球環境の保全
製品の開発、生産、販売、使用、廃棄にいたるまでのライフサイクルにおいて、環境負荷を低減し、持続可能な社会の発展に寄与します。
- 誇りある企業文化
従業員一人ひとりの個性を尊重し、その資質、能力が最大限に発揮される、活力ある組織を実現します。

連結通期

比較連結損益計算書

(単位 百万円)

期 科 目	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)		2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		前 期 比 増(減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
売 上 高	645,963	% 100.0	692,280	% 100.0	46,317
売 上 原 価	477,476	73.9	502,086	72.5	24,610
研 究 開 発 費	120,874	18.7	131,751	19.0	10,877
販売費および一般管理費	83,302	12.9	87,000	12.6	3,698
営 業 損 益	△ 35,689	△ 5.5	△ 28,557	△ 4.1	7,132
営 業 外 収 益	4,360	0.6	10,913	1.6	6,553
受取利息および配当金	1,078		1,929		851
雑 収 益	3,282		8,984		5,702
営 業 外 費 用	11,057	1.7	17,731	2.6	6,674
支 払 利 息	874		698		△ 176
雑 損 失	10,183		17,033		6,850
税 引 前 損 益	△ 42,386	△ 6.6	△ 35,375	△ 5.1	7,011
法 人 税 等	56,166	8.7	5,105	0.7	△ 51,061
少数株主損益(控除)	△ 354	△ 0.1	552	0.1	906
持分法による投資損益	—	—	△ 468	△ 0.1	△ 468
当 期 純 損 益	△ 98,198	△ 15.2	△ 41,500	△ 6.0	56,698

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

比較連結貸借対照表

(単位 百万円)

期 科目	2006年3月末	2007年3月末	前 期 比 増(減)
(資産の部)			
流動資産	413,370	381,614	△ 31,756
現金および現金同等物	211,060	185,372	△ 25,688
受取手形および売掛金	113,850	99,543	△ 14,307
たな卸資産	72,525	82,573	10,048
その他の流動資産	15,935	14,126	△ 1,809
固定資産	331,911	314,272	△ 17,639
投資等	15,597	7,154	△ 8,443
有形固定資産	302,125	292,823	△ 9,302
その他の資産	14,189	14,295	106
資産合計	745,281	695,886	△ 49,395
(負債・資本の部)			
流動負債	210,894	222,960	12,066
短期借入金	15,074	20,603	5,529
支払手形および買掛金	122,939	132,467	9,528
その他の流動負債	72,881	69,890	△ 2,991
固定負債	222,014	203,023	△ 18,991
社債および長期借入金	133,235	115,427	△ 17,808
未払退職および年金費用	75,761	71,535	△ 4,226
その他の固定負債	13,018	16,061	3,043
少数株主持分	4,122	4,835	713
資本	308,251	265,068	△ 43,183
資本金	85,955	85,955	—
資本剰余金	281,014	281,039	25
利益剰余金	△ 57,369	△ 98,901	△ 41,532
その他の包括損益累計額	△ 1,342	△ 3,017	△ 1,675
自己株式	△ 7	△ 8	△ 1
負債および資本合計	745,281	695,886	△ 49,395
有利子負債残高	148,309	136,030	△ 12,279
株主資本比率	41.4 %	38.1 %	△ 3.3 %
D/E レシオ	0.48 倍	0.51 倍	0.03 倍

【その他の包括損益累計額内訳】

・ 外貨換算調整額	7,713	10,502	2,789
・ 最小年金負債調整額	△ 14,797	—	14,797
・ 年金負債調整額	—	△ 15,937	△ 15,937
・ 有価証券未実現損益	5,754	2,418	△ 3,336
・ デリバティブ未実現損益	△ 12	—	12

連結通期

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

期 項 目	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)	前 期 比 増(減)
<u>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>			
当期純損益	△ 98,198	△ 41,500	56,698
営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整			
減価償却費	89,342	82,960	△ 6,382
受取手形および売掛金の(増加)減少額	△ 7,928	15,985	23,913
たな卸資産の(増加)減少額	△ 3,062	△ 9,333	△ 6,271
支払手形および買掛金の増加(減少)額	5,675	16,171	10,496
そ の 他	64,061	2,448	△ 61,613
計	49,890	66,731	16,841
<u>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>			
有形固定資産売却額	56,474	39,803	△ 16,671
有形固定資産購入額	△ 106,642	△ 121,126	△ 14,484
有価証券売却額	395	3,660	3,265
貸付金の(増加)減少額	△ 223	511	734
そ の 他	△ 4,677	△ 1,345	3,332
計	△ 54,673	△ 78,497	△ 23,824
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)	△ 4,783	△ 11,766	△ 6,983
<u>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>			
社債および借入金の増加(減少)額	△ 9,320	△ 13,074	△ 3,754
配当金支払額	△ 1,235	—	1,235
そ の 他	△ 1,975	△ 2,199	△ 224
計	△ 12,530	△ 15,273	△ 2,743
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	2,682	1,595	△ 1,087
現金および現金同等物純増加(減少)額	△ 14,631	△ 25,444	△ 10,813
海外子会社の決算期変更による現金および現金同等物の減少	—	△ 244	△ 244
現金および現金同等物期首残高	225,691	211,060	△ 14,631
現金および現金同等物期末残高	211,060	185,372	△ 25,688

連結第4四半期

比較連結損益計算書

(単位 百万円)

期 科目	2006年3月期 第4四半期 (自 2006年 1月 1日 至 2006年 3月31日)		2007年3月期 第4四半期 (自 2007年 1月 1日 至 2007年 3月31日)		前年同期比 増(減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
売上高	170,331	% 100.0	171,390	% 100.0	1,059
売上原価	128,750	75.6	131,017	76.4	2,267
研究開発費	36,026	21.2	35,180	20.5	△ 846
販売費および一般管理費	22,067	12.9	22,993	13.5	926
営業損益	△ 16,512	△ 9.7	△ 17,800	△ 10.4	△ 1,288
営業外収益	1,630	1.0	1,014	0.6	△ 616
受取利息および配当金	309		439		130
雑収益	1,321		575		△ 746
営業外費用	9,454	5.6	9,496	5.5	42
支払利息	260		53		△ 207
雑損失	9,194		9,443		249
税引前損益	△ 24,336	△ 14.3	△ 26,282	△ 15.3	△ 1,946
法人税等	63,476	37.2	1,831	1.1	△ 61,645
少数株主損益(控除)	△ 53	△ 0.0	168	0.1	221
持分法による投資損益	—	—	△ 78	△ 0.0	△ 78
当期純損益	△ 87,759	△ 51.5	△ 28,359	△ 16.5	59,400

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結範囲および持分法の適用に関する事項

連結子会社数	25社	(新規) 1社	NEC Electronics Korea Limited
		(除外) 2社	NEC化合物デバイス(株)、NECデバイスポート(株)
持分法適用会社数	1社	(新規) 1社	アドコアテック(株)

2. 重要な会計方針

(1) 連結財務諸表の作成基準

当社の連結財務諸表は、米国会計基準に準拠して作成しております。

(2) たな卸資産の評価方法および評価基準

主として先入先出法による低価法を採用しております。

(3) 有価証券の評価方法および評価基準

米国財務会計基準審議会基準書（以下、「基準書」）第115号「負債証券投資および持分証券投資の会計」を適用しております。

売却可能有価証券は、決算日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(4) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。

無形固定資産の減価償却方法は、主として定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、過去の貸倒損失の実績ならびに回収可能性に疑義がある受取手形および売掛金の個別評価に基づいて計上しております。

② 退職給付引当金

基準書第87号「年金に関する事業主の会計」および基準書第158号「確定給付型年金およびその他の退職後給付制度に関する事業主の会計」に準拠し、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の公正価値に基づき計上しております。

未認識の過去勤務費用または便益および保険数理上の利益または損失は、制度に基づき給付が見込まれる従業員の平均残存勤務期間にわたって均等償却しております。

<会計方針の変更>

当連結会計年度より基準書第158号を適用しております。これに基づき退職給付債務と年金資産の公正価値の差額を連結貸借対照表で認識しており、現在遅延認識されている過去勤務費用および保険数理上の損失をその他の包括損益累計額の構成要素として認識しております。この変更により、未払退職および年金費用は374百万円増加し、税効果調整後のその他の包括損益累計額は262百万円減少しております。なお、損益への影響はありません。

連結通期

セグメント情報

(1) 所在地別売上高

(単位 百万円)

		2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)		2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		
			構成比 (%)		構成比 (%)	前期比 増減率 (%)
	日 本	352,875	54.6	377,298	54.5	6.9
	米 国	76,860	11.9	67,458	9.8	△ 12.2
	欧 州	72,961	11.3	88,908	12.8	21.9
	ア ジ ア	143,267	22.2	158,616	22.9	10.7
	合 計	645,963	100.0	692,280	100.0	7.2

(2) 所在地別営業損益

(単位 百万円)

		2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)		2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		
			構成比 (%)		構成比 (%)	前期比 増(減) (百万円)
	日 本	△ 51,074	—	△ 38,877	—	12,197
	米 国	7,999	—	△ 1,006	—	△ 9,005
	欧 州	20	—	100	—	80
	ア ジ ア	7,366	—	11,226	—	3,860
	合 計	△ 35,689	—	△ 28,557	—	7,132

連結通期

(3) 製品分野別売上高

(単位 百万円)

	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)	構成比 (%)	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		前期比 増(減) 増減率 (%)	前期比 増(減)
			構成比 (%)	前期比 増減率 (%)		
通 信 機 器 分 野	107,995	16.7	99,641	14.4	△ 7.7	△ 8,354
コンピュータおよび周辺機器分野	126,581	19.6	123,714	17.9	△ 2.3	△ 2,867
民生用電子機器分野	102,639	15.9	120,757	17.4	17.7	18,118
自動車および産業機器分野	103,780	16.1	106,097	15.3	2.2	2,317
多目的・多用途 I C	69,449	10.8	88,961	12.9	28.1	19,512
ディスクリート・光・マイクロ波	108,701	16.8	120,563	17.4	10.9	11,862
半 導 体 計	619,145	95.9	659,733	95.3	6.6	40,588
そ の 他	26,818	4.1	32,547	4.7	21.4	5,729
合 計	645,963	100.0	692,280	100.0	7.2	46,317

<参考> プラットフォーム別売上高

当社は、製品分野別売上高に加えて、事業特性の類似するプラットフォーム別の売上高も開示しております。

(単位 百万円)

	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)	構成比 (%)	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)		前期比 増(減) 増減率 (%)	前期比 増(減)
			構成比 (%)	前期比 増減率 (%)		
S o C プラットフォーム	245,602	38.0	259,249	37.5	5.6	13,647
M C U プラットフォーム	156,490	24.2	168,421	24.3	7.6	11,931
個 別 半 導 体	217,053	33.7	232,063	33.5	6.9	15,010
半 導 体 計	619,145	95.9	659,733	95.3	6.6	40,588
そ の 他	26,818	4.1	32,547	4.7	21.4	5,729
合 計	645,963	100.0	692,280	100.0	7.2	46,317

(注)

S o C (システム・オン・チップ) プラットフォーム: A S I C (特定用途向け集積回路)、A S S P (特定用途向け標準品)、メモリ
M C U (マイクロコンピュータ) プラットフォーム: マイクロコントローラ、カーオーディオコントローラ
個別半導体: 表示ドライバ、アナログ I C、ディスクリート半導体、化合物半導体

金 融 商 品

(1) デリバティブ

各デリバティブ取引における帳簿価額および公正価値は次のとおりです。

(単位 百万円)

	2006年3月末		2007年3月末	
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
デリバティブ取引				
為替予約	△ 428	△ 428	157	157
金利および通貨スワップ	△ 16	△ 16	△ 13	△ 13

(2) 市場性ある有価証券

市場性ある有価証券について、有価証券の種類ごとの取得価額と時価および未実現損益は次のとおりです。

(単位 百万円)

	2006年3月末	2007年3月末
売却可能有価証券		
持分証券		
取得価額	4,231	1,933
時価	13,901	5,997
未実現損益	9,670	4,064

リ ー ス 取 引

当社は、一部の設備については、リース契約による賃借資産を使用しております。オペレーティング・リースに分類される賃借資産の解約不能期間に係る未経過リース料はそれぞれ次のとおりです。

(単位 百万円)

	2006年3月末	2007年3月末
1 年 内	19,469	24,281
1 年 超	41,684	50,677

ストックオプション

決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略します。

1株当たり当期純損益

基本的小および希薄化後1株当たり当期純損益の計算における分母の調整は次のとおりです。

	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)	増(減)
当期純損益(単位 百万円)	△ 98,198	△ 41,500	56,698
株式数(単位 株)			
加重平均発行済普通株式数	123,499,052	123,498,823	△ 229
希薄化効果のある証券の影響	—	—	—
希薄化後加重平均発行済普通株式数	123,499,052	123,498,823	△ 229
1株当たり当期純損益(単位 円)			
基本的	△ 795.13	△ 336.04	459.09
希薄化後	△ 795.13	△ 336.04	459.09

逆希薄化効果があるため、希薄化後1株当たり当期純損益の計算には含めておりませんが、将来潜在的に1株当たり損益を希薄化する可能性のある証券は次のとおりです。

(単位 株)

	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)	増(減)
転換社債	11,156,100	11,156,100	—
ストックオプション	291,500	307,000	15,500

設備投資額・研究開発費

(単位 百万円)

	2006年3月期 (自 2005年 4月 1日 至 2006年 3月31日)	2007年3月期 (自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)	増(減)
設備投資額	83,030	105,865	22,835
減価償却費	89,342	82,960	△ 6,382
研究開発費	120,874	131,751	10,877

(注) 設備投資額は、有形固定資産(ソフトウェアを除く)取得額を表示しております。

単 独

比較単独損益計算書

(単位 百万円)

期 科 目	2006年3月期 (自 2005年4月 1日 至 2006年3月31日)		2007年3月期 (自 2006年4月 1日 至 2007年3月31日)		前 期 比 増 (減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
売 上 高	506,747	% 100.0	596,141	% 100.0	89,395
売 上 原 価	385,251	76.0	437,205	73.3	51,954
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	185,813	36.7	208,170	35.0	22,357
営 業 損 益	△ 64,317	△ 12.7	△ 49,234	△ 8.3	15,083
営 業 外 収 益	2,723	0.5	3,232	0.5	509
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	1,668		2,796		1,128
雑 収 益	1,054		436		△ 619
営 業 外 費 用	5,348	1.0	9,190	1.5	3,843
支 払 利 息	657		1,398		741
雑 損 失	4,691		7,792		3,102
経 常 損 益	△ 66,942	△ 13.2	△ 55,192	△ 9.3	11,750
特 別 利 益	—	—	10,723	1.8	10,723
特 別 損 失	9,095	1.8	33,976	5.7	24,881
税 引 前 当 期 純 損 益	△ 76,037	△ 15.0	△ 78,445	△ 13.2	△ 2,408
法人税、住民税および事業税	△ 3,800	△ 0.7	△ 3,255	△ 0.6	545
法 人 税 等 調 整 額	23,727	4.6	2,331	0.4	△ 21,396
当 期 純 損 益	△ 95,964	△ 18.9	△ 77,521	△ 13.0	18,443
前 期 繰 越 利 益	11,286		—		△ 11,286
当 期 未 処 理 損 失	△ 84,677		—		84,677

単 独

比較単独貸借対照表

(単位 百万円)

期 科目	2006年3月末	2007年3月末	前 期 比 増 (減)
(資産の部)			
流 動 資 産	419,768	418,240	△ 1,527
現金および現金同等物	181,533	169,421	△ 12,113
受取手形および売掛金	82,708	75,163	△ 7,545
たな卸資産	18,975	24,429	5,453
短期貸付金	120,137	132,209	12,072
その他の流動資産	16,929	17,879	950
貸倒引当金	△ 515	△ 860	△ 345
固 定 資 産	212,880	135,663	△ 77,217
有形固定資産	54,535	32,670	△ 21,866
無形固定資産	24,494	23,551	△ 943
投資その他の資産	133,851	79,442	△ 54,409
投資有価証券	14,963	239	△ 14,724
関係会社株式	102,177	65,051	△ 37,126
長期貸付金	2,485	255	△ 2,229
その他の投資	14,225	13,897	△ 329
資 産 合 計	632,648	553,904	△ 78,744
(負債の部)			
流 動 負 債	150,059	170,637	20,578
支払手形および買掛金	67,730	82,751	15,021
一年以内返済予定長期借入金	5,000	15,000	10,000
その他の流動負債	77,329	72,885	△ 4,444
固 定 負 債	133,166	117,106	△ 16,060
新株予約権付社債	110,000	110,000	—
長期借入金	15,000	—	△ 15,000
退職給付引当金	1,317	—	△ 1,317
その他の固定負債	6,848	7,106	257
負 債 合 計	283,225	287,742	4,518
(純資産の部)			
株 主 資 本	343,676	266,154	△ 77,522
資 本 金	85,955	85,955	—
資 本 剰 余 金	342,346	257,728	△ 84,618
資 本 準 備 金	342,346	21,489	△ 320,857
その他資本剰余金	—	236,239	236,239
利 益 剰 余 金	△ 84,618	△ 77,521	7,097
その他利益剰余金	△ 84,618	△ 77,521	7,097
特別償却準備金	59	—	△ 59
繰越利益剰余金	△ 84,677	△ 77,521	7,157
自 己 株 式	△ 7	△ 8	△ 2
評価・換算差額等	5,747	△ 17	△ 5,765
その他有価証券評価差額金	5,747	△ 10	△ 5,757
繰延ヘッジ損益	—	△ 8	△ 8
新株予約権	—	25	25
純 資 産 合 計	349,423	266,162	△ 83,262
負 債 純 資 産 合 計	632,648	553,904	△ 78,744
減価償却累計額 (有形固定資産)	110,732	91,410	△ 19,322
有利子負債残高	130,000	125,000	△ 5,000
自己資本比率	55.2 %	48.0 %	△ 7.2 %
D/E レシオ	0.37 倍	0.47 倍	0.10 倍

(注)①2006年3月末の純資産の部については、従来の資本の部を会社法の様式に組替えて表示しております。

②2007年3月末における、従来の資本の部の合計に相当する金額は266,144百万円であります。

単 独

株主資本等変動計算書

当事業年度（自2006年4月1日 至2007年3月31日）

（単位 百万円）

	株主資本						株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己 株式	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	その他 利益剰余金			
				特別償却 準備金	繰越利益 剰余金		
2006年3月31日 残高	85,955	342,346	-	59	△84,677	△7	343,676
事業年度中の変動額							
資本準備金取崩 (注)		△320,857	236,239		84,618		-
特別償却準備金積立 (注)				6,463	△6,463		-
特別償却準備金取崩 (注)				△11	11		-
特別償却準備金取崩				△6,512	6,512		-
当期純損益					△77,521		△77,521
自己株式の取得						△2	△2
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)							
事業年度中の変動額合計	-	△320,857	236,239	△59	7,157	△2	△77,522
2007年3月31日 残高	85,955	21,489	236,239	-	△77,521	△8	266,154

	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計		
2006年3月31日 残高	5,747	-	5,747	-	349,423
事業年度中の変動額					
資本準備金取崩 (注)					-
特別償却準備金積立 (注)					-
特別償却準備金取崩 (注)					-
特別償却準備金取崩					-
当期純損益					△77,521
自己株式の取得					△2
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	△5,757	△8	△5,765	25	△5,739
事業年度中の変動額合計	△5,757	△8	△5,765	25	△83,262
2007年3月31日 残高	△10	△8	△17	25	266,162

(注) 2006年6月の定時株主総会における決議事項であります。

単 独

(リース取引関係)

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

		(単位 百万円)
	2006年3月末	2007年3月末
建 物		
取 得 価 額 相 当 額	5,977	5,739
減価償却累計額相当額	702	886
期 末 残 高 相 当 額	5,274	4,853
機械および装置		
取 得 価 額 相 当 額	647	227
減価償却累計額相当額	173	153
期 末 残 高 相 当 額	475	74
工具器具および備品		
取 得 価 額 相 当 額	6	14
減価償却累計額相当額	2	9
期 末 残 高 相 当 額	4	4
合 計		
取 得 価 額 相 当 額	6,630	5,980
減価償却累計額相当額	877	1,049
期 末 残 高 相 当 額	5,753	4,931

(2) 未経過リース料期末残高相当額

			(単位 百万円)	
			2006年3月末	2007年3月末
1	年	内	741	377
1	年	超	4,202	3,819
合		計	4,943	4,195

(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

		(単位 百万円)
	2006年3月期	2007年3月期
	(自 2005年4月 1日 至 2006年3月31日)	(自 2006年4月 1日 至 2007年3月31日)
支 払 リ ー ス 料	725	898
減 価 償 却 費 相 当 額	388	479
支 払 利 息 相 当 額	144	144

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。

(減損損失について)

当期および前期においてリース資産に配分された減損損失はありません。

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料			(単位 百万円)	
			2006年3月末	2007年3月末
1	年	内	9,532	15,617
1	年	超	24,373	36,347
合		計	33,905	51,964

(有価証券関係)

当期および前期において子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

〔将来予測に関する注意〕

本資料に記載されている当社および連結子会社（以下NECエレクトロニクスと総称します。）の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1) NECエレクトロニクスの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2) 市場におけるNECエレクトロニクスの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3) 激しい競争にさらされた市場においてNECエレクトロニクスが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4) 為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。
